

发票号码: 24322000000214769341

开票日期: 2024年06月21日

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司				售方	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司			
	統一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662					统一社会信用代	码/纳税人识别号:	91320903MA2	2DQUG6W
*集月	<mark>项目名称</mark> 战电路*封装芯片	规格型号 HS0860 S	单 位 DP16 只	数 量 150000 0	. 06	<mark>单 价</mark> 19469026549	金 额 9292.04	税率/征收率 13%	税 额 1207. 96
*集月	战电路*封装芯片	HS2300-P S0P14	只	100000 0	. 05′	75221238938	5752. 21	13%	747. 79
*集月	戈电路*封装芯片	HS2303-P S0P16	只	1179118 0	. 06	19469026549	73042. 71	13%	9495. 55
	合	计					¥88086.96		¥11451.30
	价税合计(大写) ◎ 玖万玖仟伍佰叁拾捌圆贰角陆分						(小写) ¥99538. 26		
备注	销方开户银行:中	国农业银行股份	有限公司盐城中汇	支行; 银行则	长号:	1040010104025	8099;		

开票人:周曰莲